



LOTPASTE SC 126

Typ ISO 1.2.2.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY SC 126** ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur die neusten Erkenntnisse in der Lötchemie, langjährige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Benutzern von Dampfphasenlötanlagen inbegriffen, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, EN-, IPC- und MIL-Normen zugrunde.

Die SC 126 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf Kunstharzbasis, das der Kl. RE L0 nach J-STD-005 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Standzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- * **SC 126*** Eine feststoffarme Paste mit nur 4,6% Rückstand.
- * **SC 126*** Die Rückstände entsprechen RE-L0 Klassifizierung.
- * **SC 126*** Enthält Korrosionsinhibitoren.
- * **SC 126*** Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang!
- * **SC 126*** Hinterläßt keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **SC 126*** Lötet problemlos auch auf leicht korrodierten Oberflächen.

PHYSIKALISCHE DATEN

Metallpulver: bevorzugte Legierungen Sn62/Pb36/Ag2 und Sn63/Pb37.

Bezeichnung der Korngröße:

Solder Chemistry	DIN 32513	Korndurchmesser	mesh size
Fein (T3)	Kl.3	20 – 45 µm	325 – 500
Superfein (T4)	Kl.4	15 – 30 µm	400 – 700

VISKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 90% Metallgehalt:

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	650-800

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am	4.Tag	21.Tag
	1,2 x 10 ¹²	8,8 x 10 ¹¹

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC 126 ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach DIN 32513) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE-L0 entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte verbleiben können.

Wenn eine Betauung der Baugruppe in der Betriebsanwendung auftreten kann, auch kurzfristig, müssen entsprechende Feuchteschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozeß darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen. Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15 – 100 mm/s.

Merke! Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in der Linie.

Das wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen.

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Wir empfehlen daher den SC Schablonenreiniger. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen aufschmelzbar.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT): 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird. Wir empfehlen eine maximale Verarbeitungszeit von sechs Stunden nach dem Druck. Auf der Schablone kann die Paste maximal 12h verbleiben. Unter Idealbedingungen wurden in der Praxis aber auch schon 24h Standzeit erreicht!

Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste:

<u>Legende</u>	<u>Pastentyp</u>	<u>Korngröße</u>	<u>Legierung</u>	<u>Flußmittelanteil</u>	<u>Gebindegröße</u>
z.B.	SC 126	T3	62/36/2Ag	10%	500g
	SC 126	T3	63/37	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste (SC...) L-Sn62PbAg2 / F-SW 32 / 90 – 3 200g (Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.SolderChemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.